

证券代码：688261

证券简称：东微半导

## 苏州东微半导体股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：IR2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中信证券、人保资产、中欧基金、建信资管、中韩人寿、工银安盛
会议地点	江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	龚轶（董事长兼总经理）、李麟（董事兼董事会秘书）、张威（投资者关系总监）
交流时间	2024 年 7 月 11 日
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：印象里公司在光储领域收入占比较高，目前单季度大概是什么情况，能否分拆一下下游应用领域的结构变化？</p> <p>答：目前下游应用领域仍然主要分布在新能源汽车直流充电桩领域、各类工业和通信电源领域，包括数据中心和算力服务器电源，光伏和储能领域、车载充电机领域等，消费类产品占比较低。具体的占比情况以公司披露的 2024 年半年度报告为准。</p> <p>问题二：公司一直以来的特色是比较懂工艺，研发</p>

生产一款产品，需要跟代工厂有较强的配合，在工艺端有很强的突破，这方面之前可能是在海外工厂做的比较好，请问公司是如何解决工艺配合问题，是否主要跟华虹配合？

答：公司长期以来与上游供应商保持长期稳定的战略合作关系与高效的联动机制，具有与上游供应商合作并实现深度定制化开发的能力。由于功率器件的制造工艺较为特殊，特别是高性能产品的开发需要器件设计与工艺平台的深度结合，研发团队需对晶圆厂的基准工艺平台进行深度优化和定制设计。在产品研发阶段，公司会与晶圆厂进行深度的共同讨论，通过多次反复工艺调试，使得晶圆厂的工艺能更好地实现公司所设计芯片的性能，最终推出经优化的产品，更好地贴合终端客户的需求。在这个过程中，晶圆代工厂的工艺能力亦在双方互相协作中获得优化和提升，实现了双方技术能力的相互促进和提升。在产能相对缓和的时候，我们完成了大量之前积累的研发工作，像 8 英寸到 12 英寸的产品转产工作，进一步优化产品成本。

**问题三：上游产能的变化情况对公司的定价策略有何影响？**

答：公司拥有众多行业标杆、工业级和新能源汽车客户，我们希望提供性能和质量更优、可靠性更高的产品给客户，与客户有更深度的长期稳定的合作关系。公司着眼于长远利益，会依据上下游供给关系、上游晶圆成本的变化等因素综合考量，尽量维持合理的价格与毛利，维护双方的长期合作关系，这是公司一贯以来的市场策略。

	<p><b>问题四：作为一家功率器件公司，为什么不选择 IDM 模式？</b></p> <p>答：目前半导体行业整体呈现 IDM 模式与 Fabless 模式共存的局面，同时由于半导体行业的周期性特点，IDM 与 Fabless 模式各有优缺点。公司作为一家技术驱动型的专业的半导体功率器件设计及研发企业，自成立以来始终采用 Fabless 的经营模式，专注于芯片的研发与销售。在目前上游产能相对充足的情况下，如何用好代工厂的资源，与代工合作伙伴依托各自在技术、产能等方面的优势，共同开发出更多优秀的产品系列，进而提高各自的竞争力，尤为重要。</p> <p><b>问题五：从长远发展来看，公司觉得比较满意的阶段，应该达到什么样的水平或状态？</b></p> <p>答：企业发展是没有止境的，现在产业链相对成熟，市场机遇较大，我们能抓住的机会也很多，关键在于能否执行好。公司可以做的事情很多，短期来说比如在第三代半导体领域做出更好的产品，形成更规模化的销售。我们一直定位在做难做的产品，理想状态是每条产品线都能均衡发展，相信未来公司会有更大的进步。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
来访时间	2024 年 7 月 11 日